

檔 號：
保存年限：

經濟部智慧財產局 函

地址：10637臺北市辛亥路二段185號3樓
承辦人：李雅婷
電話：(02)23766131
傳真：(02)27374030
電子信箱：ting00722@tipo.gov.tw

受文者：科技部

發文日期：中華民國108年05月07日
發文字號：智國企字第10811003960號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：敬請貴部協助將「2019台灣創新技術博覽會」發明競賽徵
展訊息轉知各相關學研單位，並鼓勵各界踴躍報名參展，
以共同促進專利技術商品化與產業化，至紉公誼。

說明：

- 一、本展去年展出近1,500項發明專利與創新技術，並邀請來自全球33個國家之發明人及廠商共襄盛舉，展期3天計吸引45,091人次買主及民眾前來觀展及尋找交易商機。
- 二、2019台灣創新技術博覽會將於本(108)年9月26日至28日假台北世貿一館盛大展出，預計邀請20個以上國家、600家以上國內外發明人及廠商參展。其中發明競賽展區將同步舉辦發明競賽，藉由競賽的肯定，促進得獎作品交易商機。
- 三、本展報名期間自108年4月19日至6月30日止，展覽相關訊息、參展說明及報名表電子檔，請逕至本展專屬網站(<https://www.inventaipai.com.tw/>)查詢及下載使用。

正本：科技部、教育部

副本：財團法人中華民國對外貿易發展協會

